

# 株式会社リョーサン

## 2016年度第2四半期 決算説明会

---

2016年11月16日

代表取締役社長執行役員

三松 直人

## 2016年度 第2四半期 業績結果

## 2016年度 通期 業績計画

## 第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

### 資料取扱い上のご注意

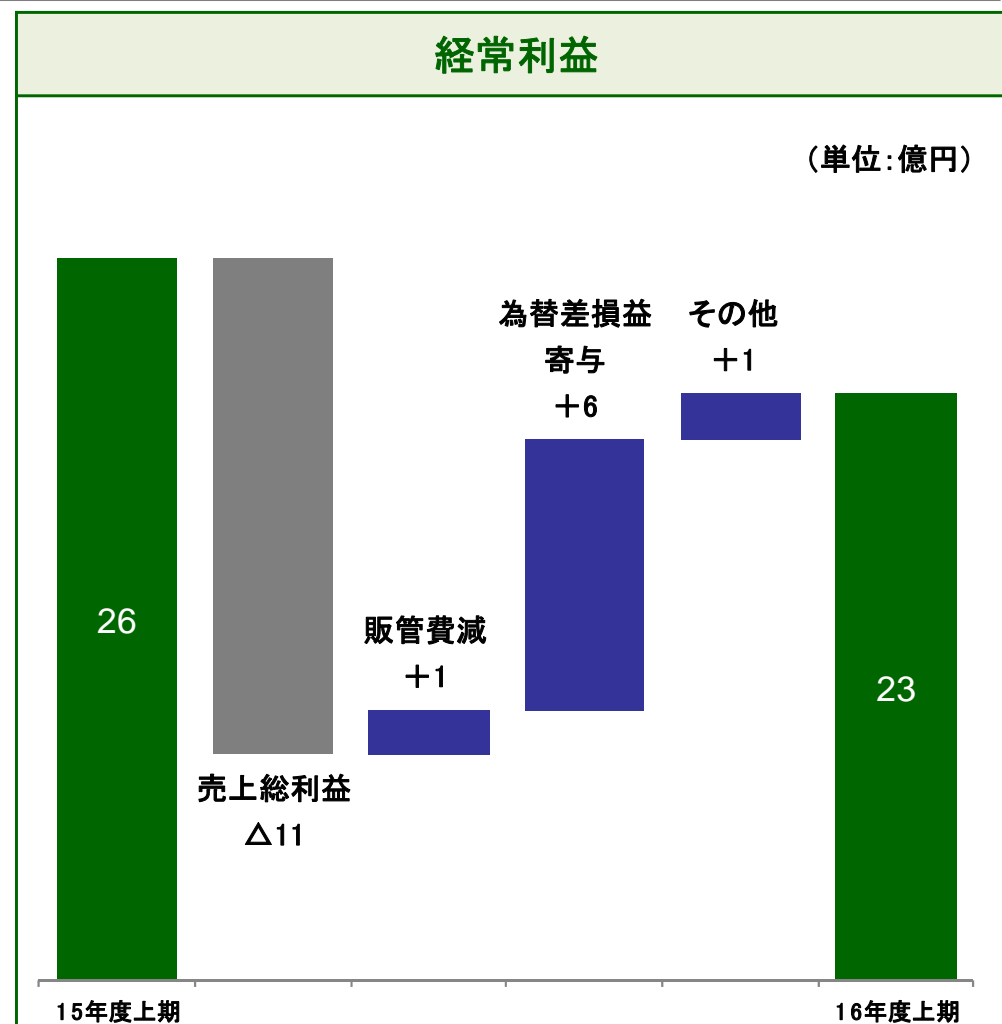
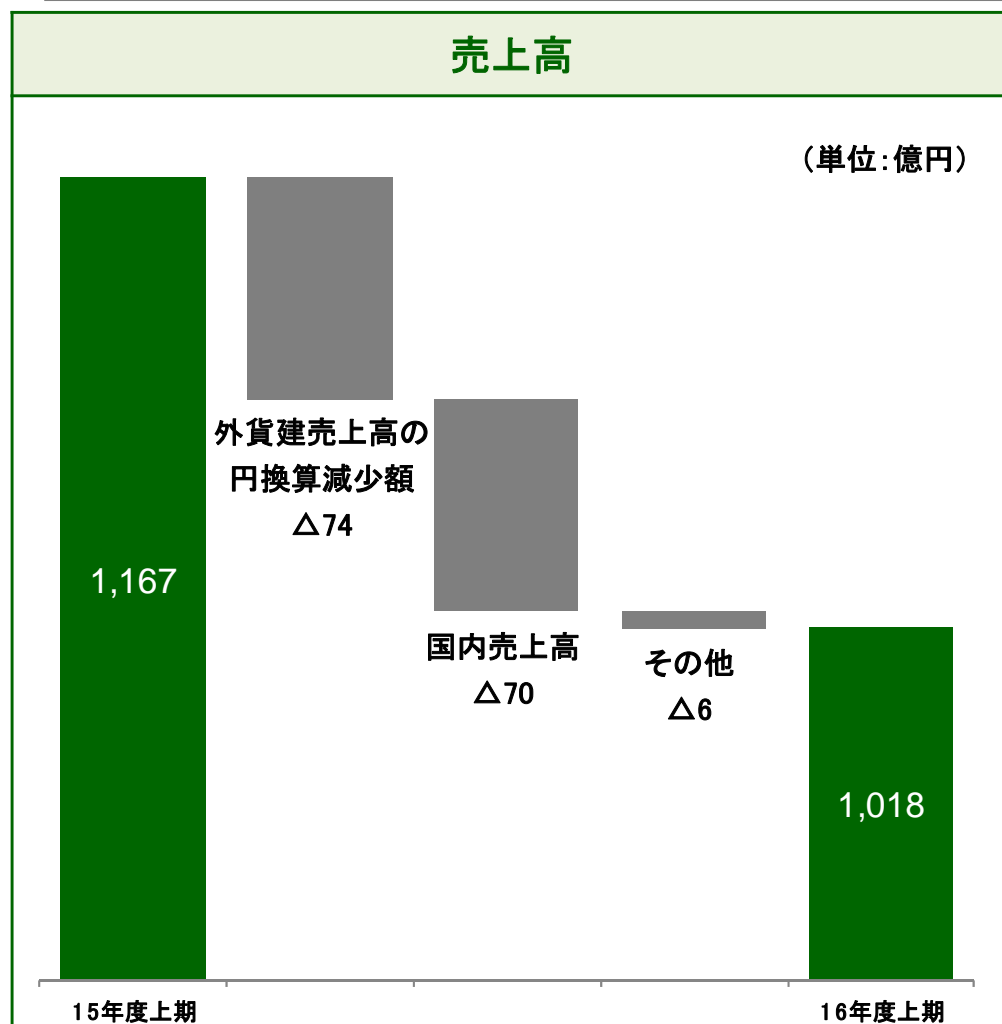
このプレゼンテーションで述べられている業績計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

- ・主要市場(日本、アジア等)の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等

- 16年度上期実績は、円高影響、15年度大口案件の終息、需給バランス悪化に伴う伸び悩み等により、前年同期比で減収減益。最終損益は期初計画をクリア。

	15年度上期		16年度上期			
	金額	%	金額	%	前年同期比	期初計画
売上高	1,167		<b>1,018</b>		△12.7%	1,100
売上総利益	97	8.3%	<b>85</b>	8.4%	△11.6%	94
販売管理費	68	5.9%	<b>67</b>	6.6%	△2.4%	71
営業利益	28	2.4%	<b>18</b>	1.8%	△34.0%	23
経常利益	26	2.3%	<b>23</b>	2.3%	△11.8%	23
当期純利益	18	1.6%	<b>17</b>	1.7%	△7.4%	15
1株当たり当期純利益(円)	59.30		<b>58.13</b>		△2.0%	50.91
国内売上高	683	58.5%	<b>613</b>	60.2%	△10.3%	
海外売上高	484	41.5%	<b>405</b>	39.8%	△16.2%	

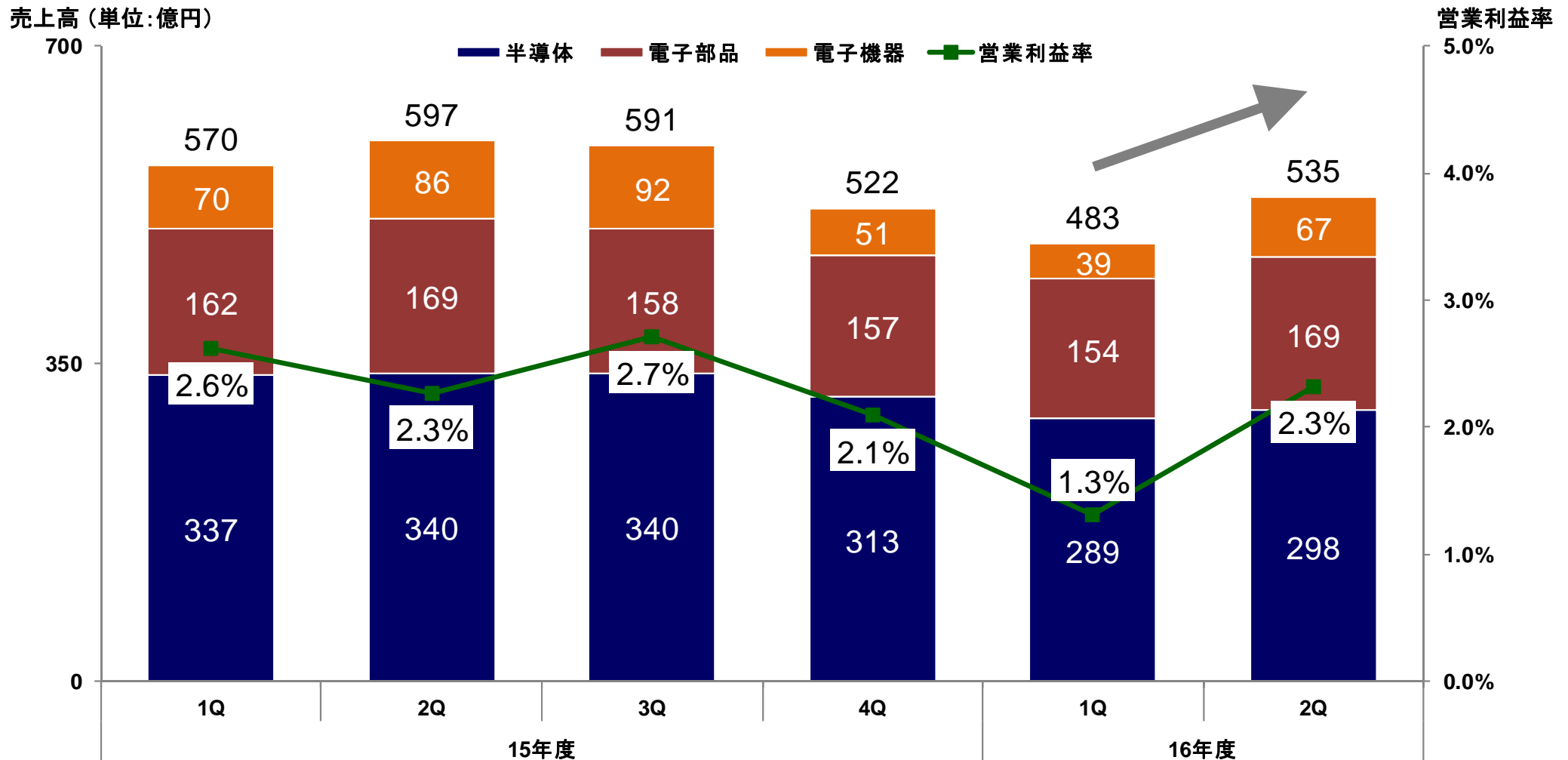
- 売上高の減少は外貨建売上高の円換算額減少や、15年度大口案件のMFP用システム機器ビジネス終息等による国内売上の落ち込みに伴うもの。
- 経常利益は、外貨建て資産・負債の評価替え等による為替差損益で押し上げたものの、前年同期比減益。



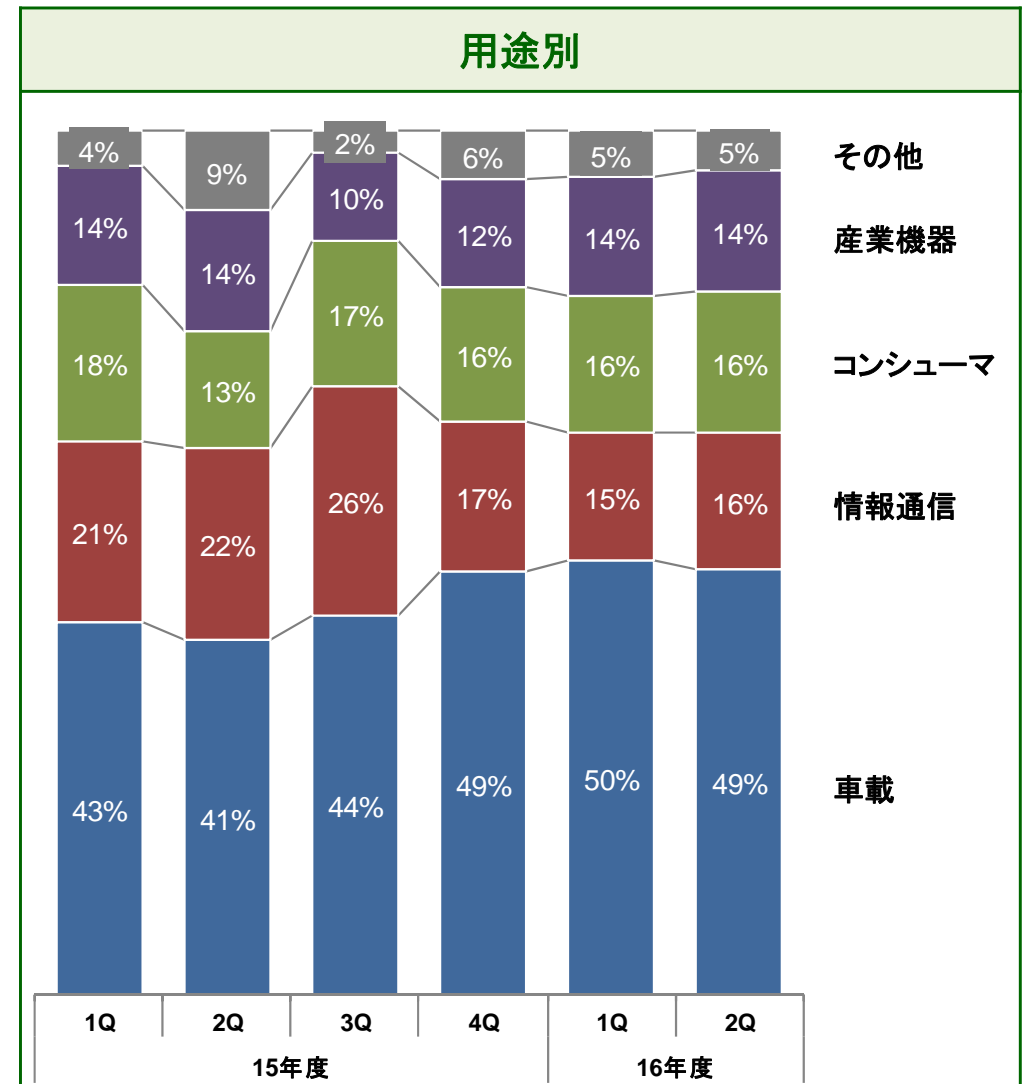
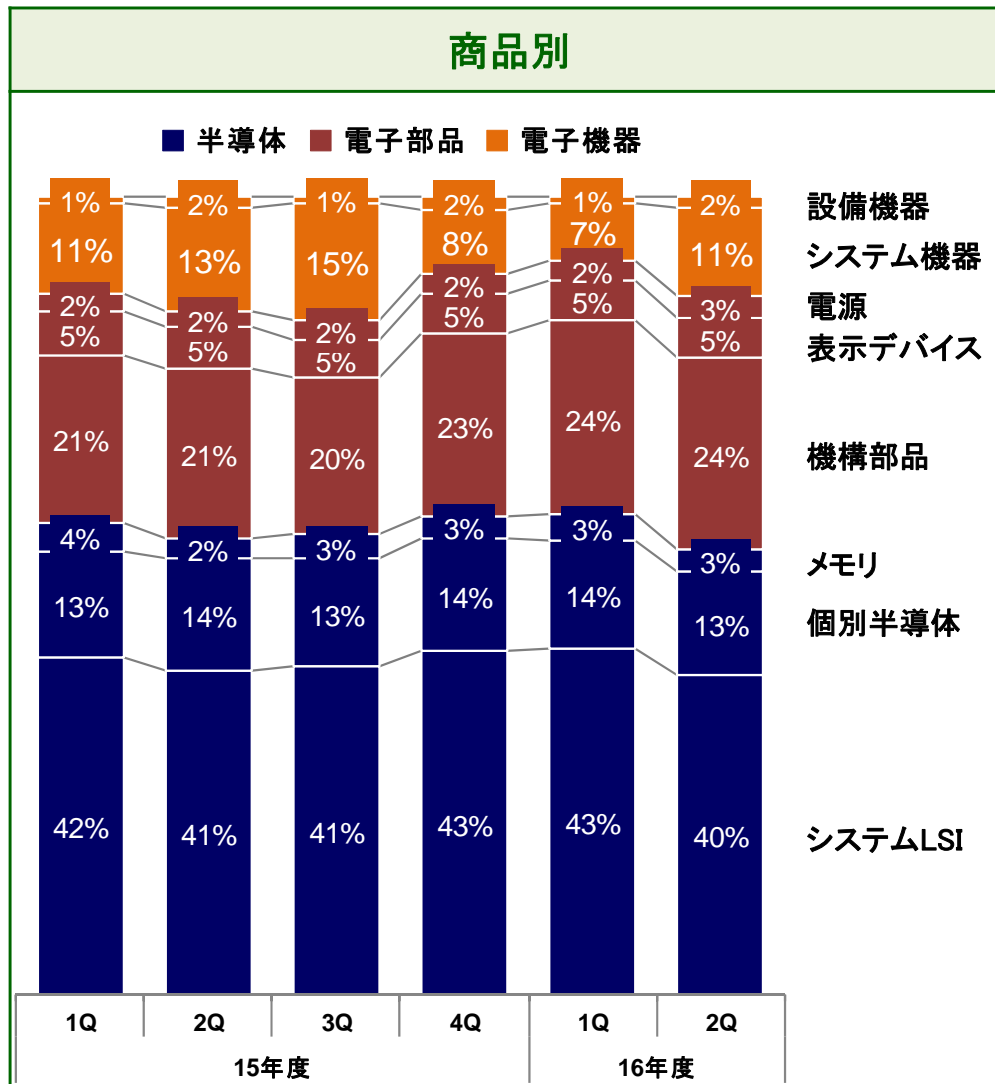
- 半導体事業は円高影響、情報通信端末向けビジネス終息、カーナビ・カーオーディオやデジタルカメラの販売不振の影響等を受け、減収減益。
- 電子部品事業も同様に円高影響を受けたが、車載向けビジネスが堅調に推移。
- 電子機器事業はMFP向けビジネス終息の反動によるもの。

		15年度上期		16年度上期		(単位:億円) 前年同期比
		実績	%	実績	%	
半導体事業	売上高	677		<b>588</b>		△13.2%
	営業利益	14.2	2.1%	<b>10.8</b>	1.8%	△23.8%
電子部品事業	売上高	332		<b>323</b>		△2.8%
	営業利益	9.0	2.7%	<b>8.1</b>	2.5%	△9.2%
電子機器事業	売上高	156		<b>106</b>		△31.9%
	営業利益	7.3	4.7%	<b>3.1</b>	3.0%	△57.0%
営業利益調整額		△2.1		<b>△3.4</b>		
計	売上高	1,167		<b>1,018</b>		△12.7%
	営業利益	28.4	2.4%	<b>18.7</b>	1.8%	△34.0%

- 新興国市況悪化による半導体事業の低迷、MFP向けビジネス終息に伴う電子機器事業の落ち込みにより、15年度2Qをピークに減収傾向。
- 電子部品事業は堅調(車載向けビジネス)。電子機器事業も車載向け案件を獲得したことによって16年度1Qで底打ち。営業利益率も売上高増加に伴い改善。



■ 商品別構成比に大きな変化はない。用途別では、情報通信向け売上高構成比が縮小する一方で、車載向け売上高構成比が高まる。



- 配当金の支払い27億円、自己株式の取得19億円等により、現預金及び有価証券が40億円減少、純資産を圧縮。
- 営業活動によるキャッシュ・フローの増加は、仕入債務が増加したため。

## ■ 連結貸借対照表

(単位: 億円)

	16年3月末	16年9月末	比較増減
総資産	1,570	<b>1,529</b>	△40
流動資産	1,391	<b>1,355</b>	△36
固定資産	178	<b>174</b>	△3
負債	416	<b>430</b>	+13
純資産	1,153	<b>1,099</b>	△54
自己資本比率	73.5%	<b>71.9%</b>	△1.6

## ■ 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 億円)

	15年度上期	16年度上期	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2	<b>24</b>	+26
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1	<b>0</b>	+2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21	<b>△54</b>	△33
現金及び現金同等物の四半期末残高	529	<b>466</b>	△62



2016年度 第2四半期 業績結果

2016年度 通期 業績計画

第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

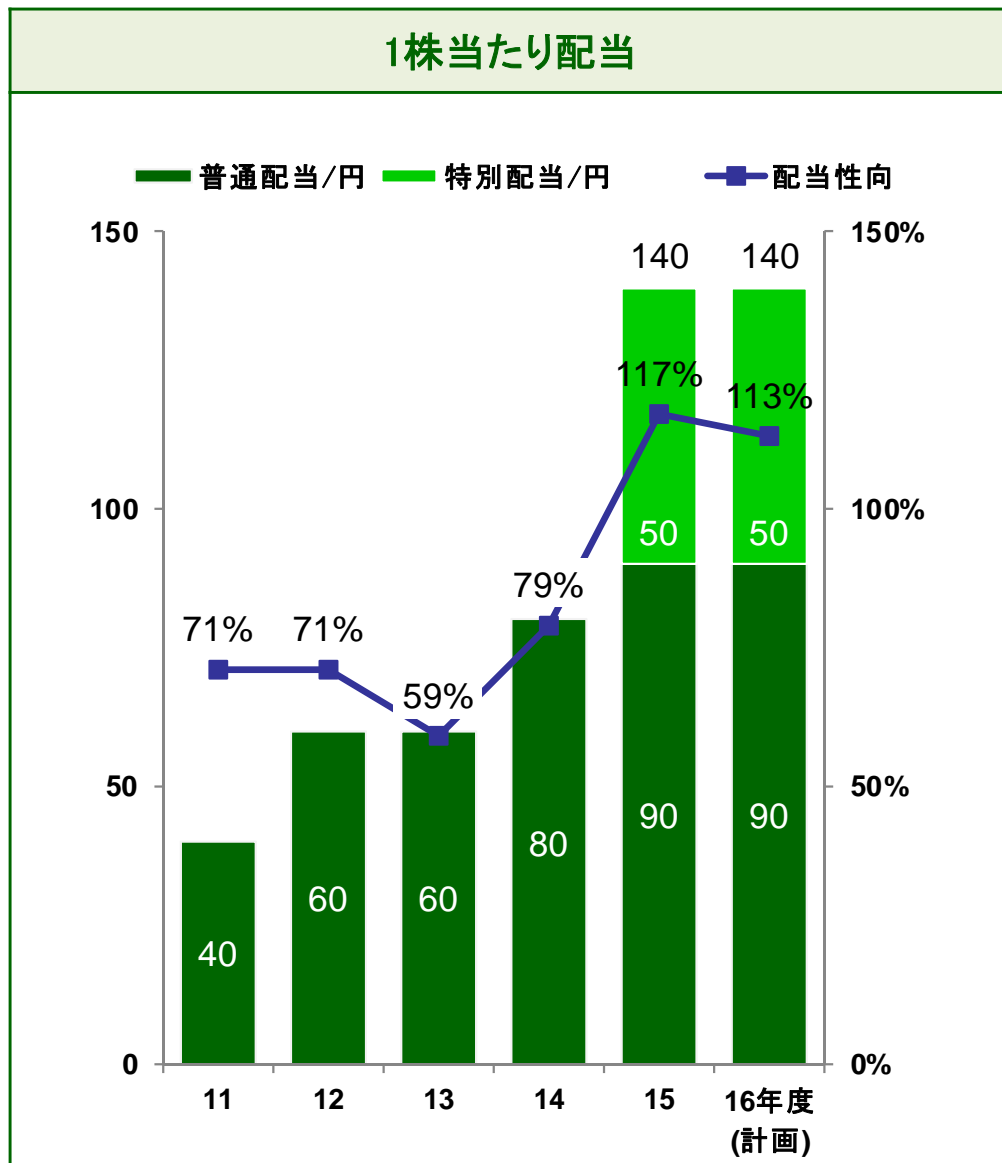
- 下期にかけて各セグメントともに受注額は改善し、上期比増収増益。
- 通期では、円高による想定為替レートの見直し(USD121円→105円)影響が大きく、期初計画を下方修正。

	15年度		16年度					(単位:億円)
	通期	%	上期	下期計画	通期計画	%	前期比	
売上高	2,281		1,018	1,131	<b>2,150</b>		△5.8%	2,300
売上総利益	193	8.5%	85	93	<b>179</b>	8.3%	△7.3%	196
販売管理費	137	6.0%	67	67	<b>135</b>	6.3%	△2.0%	140
営業利益	55	2.4%	18	25	<b>44</b>	2.0%	△20.6%	56
経常利益	55	2.5%	23	25	<b>49</b>	2.3%	△12.4%	56
当期純利益	36	1.6%	17	18	<b>36</b>	1.7%	△1.9%	37
1株当たり当期純利益(円)	119.77		58.13	65.65	<b>123.78</b>		+3.3%	125.57
国内売上高	1,334	58.5%	613	666	<b>1,280</b>	59.5%	△4.1%	1,300
海外売上高	947	41.5%	405	464	<b>870</b>	40.5%	△8.2%	1,000

- 下期は全セグメントにおいて上期比増収増益。
- 通期では、半導体事業は円高影響、電子機器事業はMFPビジネス終息の反動が大きく、前期水準には届かない計画。電子部品事業は車載向けビジネスの堅調継続、コンシューマ向け機構部品の販売増も見込まれ、増収増益計画。

		15年度		16年度					
		通期	%	上期	下期計画	通期計画	%	前期比	期初計画
半導体事業	売上高	1,331		588	656	<b>1,245</b>		△6.5%	1,360
	営業利益	29.5	2.2%	10.8	14.1	<b>25.0</b>	2.0%	△15.4%	34.0
電子部品事業	売上高	649		323	356	<b>680</b>		+4.7%	685
	営業利益	15.4	2.4%	8.1	10.8	<b>19.0</b>	2.8%	+23.4%	19.5
電子機器事業	売上高	301		106	118	<b>225</b>		△25.3%	255
	営業利益	15.0	5.0%	3.1	3.8	<b>7.0</b>	3.1%	△53.6%	7.5
営業利益調整額		△4.6		△3.4	△3.5	<b>△7.0</b>			△5.0
計	売上高	2,281		1,018	1,131	<b>2,150</b>		△5.8%	2,300
	営業利益	55.3	2.4%	18.7	25.2	<b>44.0</b>	2.0%	△20.6%	56.0

- 今期配当方針に変更はなく、普通配当金90円、特別配当金50円以上を計画。
- 自己株式の取得は、期間16年7月から17年3月末、上限300万株で実施中。



### 自己株式の取得

期間	取得株数(万株)	金額(億円)
2011年8～11月	100	17
2013年2月	100	19
2013年5～6月	100	18
2015年2～3月	45	13
2015年10月	23	6
2015年11月～2016年2月	132	40
2016年7～10月末現在	86	26

2016年度第2四半期 業績結果

2016年度通期 業績計画

第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

## 第9次中期経営計画の基本姿勢

「変革」と「成長」

事業構造の変化に対応した「ビジネスモデルの転換」と  
持続可能な「自律的成長」の追求

## 取り組みの概要

成長路線の再構築

新たなビジネスモデルの創出  
(システムソリューション力の強化)

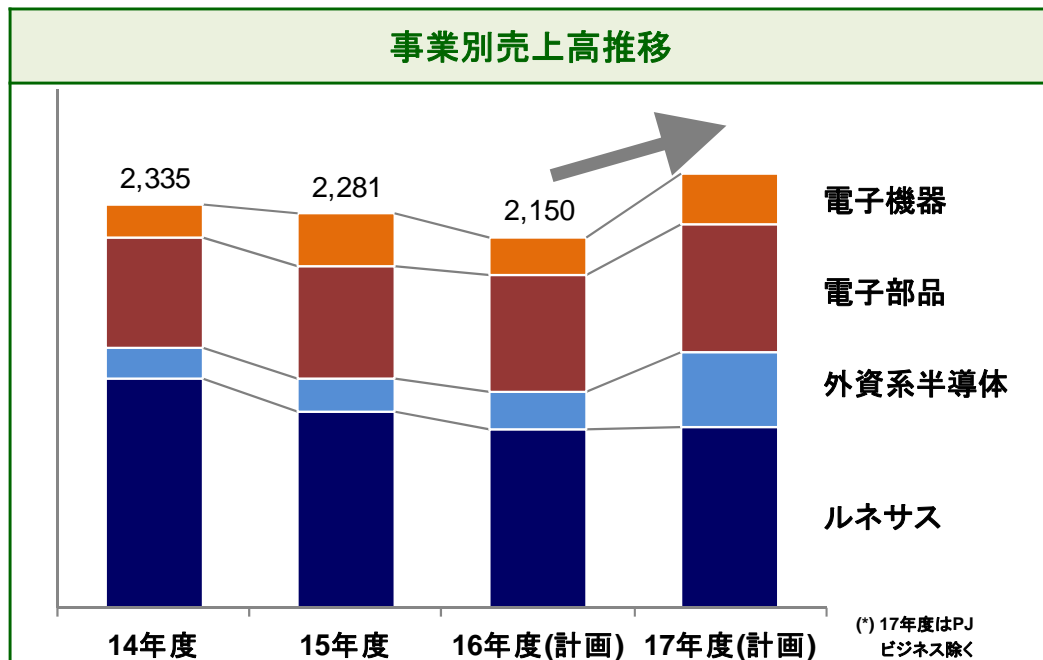
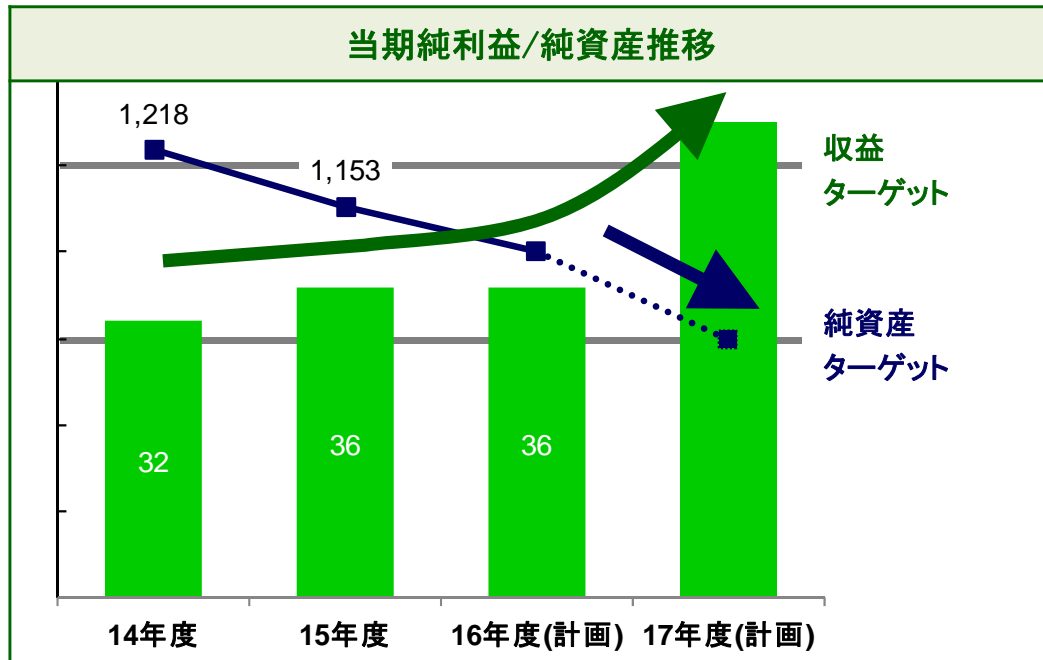
マルチベンダー化の更なる推進  
(既存ビジネスにおける新たなサプライヤーおよび新規商材の拡充)

グローバル対応強化による海外ビジネスの拡大  
(グローバルディストリビューターを目指す)

資本効率の向上

成長に向けた積極的な投資

自己株式の取得



<b>ROE5%</b>	<b>全体施策</b>
<b>売上高利益率</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 半導体事業第2、第3の柱構築</li> <li>■ 新規サプライヤーの獲得、事業拡大</li> <li>■ 非日系ローカル取引の拡大</li> <li>■ 車載ビジネスへのリソース強化</li> </ul>
×	
<b>総資産回転率</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 政策保有株式の見直し</li> <li>■ 資産効率改善</li> </ul>
×	
<b>財務レバレッジ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自己株式取得</li> <li>■ 特別配当</li> </ul>



- 経済状況の急激な変動
- 仕入先の再編
- 為替レートの変動
- 自然災害

施策の柱	実績	今後の打ち手
<p>新たなる ビジネスモデルの 創出</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ソリューション事業本部立ち上げ。 執行役員の配置。</li> <li>■ 見守り・介護、都市・道路分析、鳥獣対策 事業等の新規ビジネスモデルの推進。</li> <li>■ 第19回組込みシステム開発技術展 (ESEC2016)に出展。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 構築したビジネスモデルの事業化。</li> </ul>
<p>マルチベンダー化 の更なる推進</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 新規サプライヤーとの取引開始。                     <ul style="list-style-type: none"> <li>— 外資系半導体事業：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ON Semiconductor社</li> <li>・Microchip Technology社 他</li> </ul> </li> <li>— ソリューション事業：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・VIA Technologies社</li> <li>・フジプレアム社 他</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>■ 販売推進体制の再編。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 半導体メーカーの再編を起点とする 商権拡大・事業拡大への取り組み。</li> <li>■ M&amp;Aを通じた既存商権拡大。</li> <li>■ 戦略商品に対する組織的な販促活動 促進。</li> </ul>
<p>グローバル対応 強化による 海外ビジネスの 拡大</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中国、アセアン地域の本部化。 執行役員の常駐。</li> <li>■ ドイツ進出日系メーカー研究開発拠点を ターゲットとする新規拠点開設。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 中国華南地区への戦略投資検討。</li> </ul>



